



DISCO

Kiru · Kezuru · Migaku Technologies



乾式拋光磨輪

系列

DP08 SERIES
Dry Polishing Wheels

無需使用化學藥品即可去除殘餘應力的乾式拋光輪

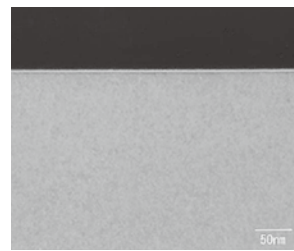


該產品不僅適用於一般的晶圓研磨，亦適用於DBG技術，無需使用化學藥品即可去除殘餘應力

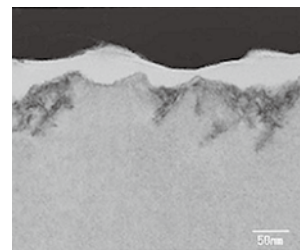
DP08系列利用迪思科公司獨創的乾式拋光技術，可以對超薄晶圓進行研磨。無需使用化學藥品，因此對環境負荷小，而且與使用研磨液（膏）相比，操作更容易，實現了高抗折強度的晶片。

■ 研磨損傷比較 (TEM觀察)

經過乾式拋光加工後，可除去晶圓中的研磨損傷。



DP08拋光後



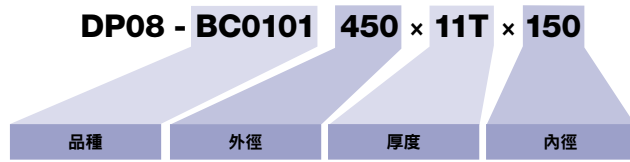
#2000研磨後



加工對象 矽晶圓、其他材料

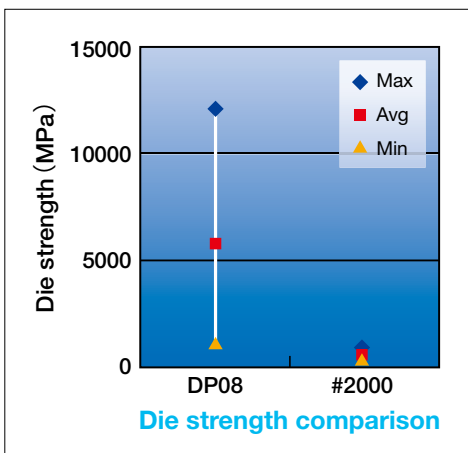
DP08 SERIES

Dry Polishing Wheels



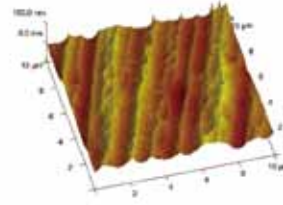
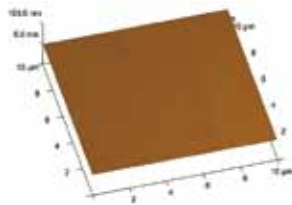
實驗結果

■ 抗折強度 (球壓式抗折強度測量法)



工作物 : $\phi 8''$ 矽晶圓
最終加工厚度 : 200 μm

■ 表面粗糙度



	DP08系列	Grinding Wheel (#2000)
Ra (μm)	0.0003	0.0146
Ry (μm)	0.0017	0.0814

本公司的所有產品都已加入產品賠償責任保險。

下訂單時

在下訂單時，請用戶將產品的類型名稱、外徑、研削磨輪直徑及數量通知本公司，另外在初次訂購時，本公司銷售窗口會根據不同加工要求，協助用戶選擇最適合的產品，屆時請一併提供研削材料、尺寸、形狀、所用設備(裝置)及其他相關加工條件等資料。

為了改進產品，本公司可能在未通知用戶的情況下，就對產品規格進行變更，因此請仔細核對規格後再下訂單。



為了安全使用本公司的各種產品

為了預防發生因研削磨輪、切割刀片(以下通稱精密加工工具)的破損而造成的各種事故和人身傷害，請嚴格遵守下列各注意事項。

- 請使用安全擋板(包括噴嘴外殼或外蓋)。
- 在使用有限制旋轉數的精密加工工具時，請不要超出其規定的旋轉數範圍。
- 在安裝精密加工工具時，請遵照設備(裝置)使用說明書的規定，正確地進行安裝。
- 請不要使精密加工工具掉落在地上，或發生碰撞。
- 在每次使用精密加工工具前必須先進行檢查，如果有缺口或其他破損，請停止使用。
- 在開始使用前，請先仔細閱讀相關設備(裝置)的使用說明書。
- 請不要使用經過改裝的設備(裝置)。
- 請不要使用不符合設備(裝置)指定尺寸的精密加工工具。
- 除了研削、切割及切削作業以外，請不要使用在其他用途。
- 在使用濕式研削、切割用精密加工工具時，請使用冷卻液。



DISCO CORPORATION

東京都大田區大森北2-13-11 〒143-8580

Phone: 81-3-4590-1000 Fax: 81-3-4590-1001 www.disco.co.jp